

2012年11月12日

**セミコン・ジャパン 2012出展のお知らせ**  
(出展位置:3C-901/ホール3)

**SEMICON®**  
**Japan2012**

弊社は半導体製造装置・材料の国際展示会である「セミコン・ジャパン 2012」に出展致します。

セミコン・ジャパンは、半導体を中心としたマイクロエレクトロニクスの製造を支える装置・材料産業における世界を代表する総合イベントです。

業界の最新技術動向や装置・部材の実物展示のほか、各種研究論文の発表やテーマ別セミナーも開催されます。参加者は毎年延べ10万人近くにのぼり、業界最大規模の展示会となっております。

当社の出展は13年連続となり、半導体およびFPD(フラットパネルディスプレイ)等の電子デバイス製造装置を取り扱う専門部である「電子デバイス設備部」が出展し、同部が行っている①半導体製造装置のリース事業 ②中古半導体製造装置の売買事業 ③半導体製造装置の改造・再生を中心とした技術サービス事業の3つの事業を組み合わせ、お客様に最適な設備導入手段を提供する「トリニティー(三位一体)・サービス」をご紹介します。是非ご来場くださいませ。



2011年の出展の様子

【開催概要】

名称 : [セミコン・ジャパン2012](#)  
会期 : 2012年12月5日(水)～7日(金) 10:00-17:00  
会場 : 幕張メッセ 千葉市美浜区中瀬2-1  
出展位置: [3C-901](#) [ホール3](#)  
主催 : SEMI (Semiconductor Equipment and Materials International)

お問合せ窓口  
三井住友ファイナンス&リース株式会社  
電子デバイス設備部  
TEL: 03-3515-1940 / FAX: 03-3515-1959  
Mail: [semicon@smfl.co.jp](mailto:semicon@smfl.co.jp)

以上